



華邦電子股份有限公司個人資料

蒐集、處理及利用告知書

(公司甄選階段應徵人員填寫)

致：_____先生/女士

華邦電子股份有限公司(以下簡稱本公司)基於徵才及從事各項相關業務之目的(註1)，自您於應徵本公司職務之日起，得蒐集各項得以直接或間接識別您的個人資料(註2)，並於中華民國境內處理、利用及國際傳輸，亦得提供給與從事各項業務目的相關之公務機關及非公務機關於中華民國境內處理、利用及國際傳輸，本公司茲依據個人資料保護法告知下列事項：

對個人資料利用之期間、地區、對象及方式：

1. 期間：

- (1) 個人資料蒐集之特定目的存續期間；或
 - (2) 自您資料交付日期之日起算5年。
- 以上述期間較長者為準。

2. 地區：下列對象之國內及國外所在地。

3. 對象：各項業務目的相關之公務機關及非公務機關(包括但不限於入出國及移民署、稅務機關、勞保局、健保局、團體保險承辦公司、各項員工福利活動之合作廠商、撥薪銀行、旅行社、航空公司、本公司之關係企業、股務代理公司、職工福利委員會等)。

4. 方式：

對個人資料利用之方式：符合個人資料相關法令以自動化機器或其他非自動化之利用方式之蒐集、處理、國際傳輸與利用(例如使用電子文件、紙本或其他合於當時科學技術之適當方式等)。

就您的個人資料，經您書面同意或有以下情形之一，本公司得為前述目的外之利用：

- 1. 法律明文規定。
- 2. 為增進公共利益。
- 3. 為免除您的生命、身體、自由或財產上之危險。
- 4. 為防止他人權益之重大危害。
- 5. 公務機關或學術研究機構基於公共利益為統計或學術研究而有必要，且資料經過本公司處理後或蒐集者依其揭露方式無從識別特定之當事人。

就本公司所保有的您的個人資料，您得行使下列權利：

- 1. 向本公司查詢、請求閱覽或請求製給複製本，但若有妨礙本公司或第三人之重大利益時，不在此限。本公司於答覆查詢、提供閱覽或製給複製本時，得向您酌收必要成本費用。
- 2. 向本公司請求補充或更正，但您應就其原因及事實為適當之說明。
- 3. 向本公司請求停止蒐集、處理或利用及請求刪除，惟本公司因執行職務或業務



所必須，得不依您的請求辦理。

就您所提供之第三人資料(如您的眷屬資料、緊急聯絡人等)，您確認已告知各該當事人，並已取得各該當事人之同意本公司得為前述目的之處理、利用及國際傳輸。

您得自由選擇是否提供個人資料(目前尚未提供予本公司者)，惟您若選擇不提供，或只提供部份/不完全/不真實/不正確個人資料予本公司，本公司有權決定是否進入甄選階段。

您同意本公司有權修訂本告知書，並同意本公司於修訂後，得以言詞、書面、電話、簡訊、電子郵件、傳真、電子文件或其他足以使您知悉或可得知悉之方式(包括但不限於以前述方式告知提供詳載本告知暨同意書內容之網站連結)，告知修訂要點及指定網頁。

註 1. 依法務部「個人資料保護法之特定目的及個人資料之類別」，包括但不限於「人事管理」、「公共衛生或傳染病防治」、「非公務機關依法定義務所進行個人資料之蒐集處理及利用」、「契約、類似契約或其他法律關係事務」、「依法定義務所進行個人資料之蒐集處理及利用」、「產學合作」、「僱用與服務管理」。

註 2. 依法務部「個人資料保護法之特定目的及個人資料之類別」，包括但不限於：識別個人者、識別財務者、政府資料中之辨識者、個人描述、身體描述、習慣、個性、家庭情形、家庭及其他成員之細節、其他社會關係、移民情形、休閒活動及興趣、旅行及其他遷徙細節、執照或其他許可、學校紀錄、資格或技術、職業專長、著作、學生(員)及應考員紀錄、現行之受僱情形、僱用經過、離職經過、工作及差勤紀錄、健康與安全紀錄、工會及員工之會員資格、薪資與預扣款、津貼、福利、受僱人所持有之財產、工作管理之細節、工作之評估細節、受訓紀錄、健康紀錄等。

中 華 民 國 年 月 日

個人資料蒐集、處理及利用同意書

立同意書人_____ (以下簡稱本人)，本人已詳細閱讀、清楚瞭解並同意上述 貴公司對本人個人資料之蒐集、處理、利用及國際傳輸之相關告知事項。

此致

華邦電子股份有限公司

立同意書人：_____ (請親筆簽名)

身分證統一編號/護照編號：_____

中 華 民 國 年 月 日